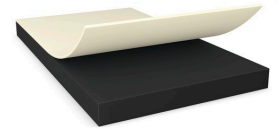




# tesa® LTC 58722

## 产品信息



## 50 µm 低温热反应结构性粘接胶带

### 产品描述

tesa® LTC 58722是一款在中等温度下激活的热反应结构性粘接胶带。这种黑色胶带没有基材。它由PE涂层离型膜保护。

### 特点

- 出色的高粘性和可靠性，即使在纤薄间隙设计上也是如此。
- 在低温低压下激活
- 出色的抗冲击性能
- 耐化学腐蚀性
- 在金属上的可靠性能尤为突出
- 低溢胶率
- tesa® LTC 58722不含卤素，符合现行RoHS标准。

### 应用

tesa® LTC 特别推荐用于电子设备内部各种材料的结构性粘接：

- 金属的结构性粘接
- 敏感型电子元器件粘接

### 技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

- |         |          |       |       |
|---------|----------|-------|-------|
| • 基材    | 无        | • 总厚度 | 50 µm |
| • 胶粘剂类型 | 低温反应型胶粘剂 | • 颜色  | 黑色    |
| • 离型纸类型 | PE涂层纸    |       |       |

### 属性/性能值

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| • 粘接强度 (推出) | 3 N/mm <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|

### 附加信息

技术建议：

tesa® LTC为非自粘胶带。它通过在一定时间内施加热量和压力来激活。以下参数值是胶层初始设置的推荐值。

#### 1) 预贴合

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58722>



# tesa® LTC 58722

## 产品信息

### 附加信息

在预贴合过程中，将胶带贴合到第一个元器件上。设置：

- 温度<sup>1</sup> 50-60 °C
- 压力<sup>2</sup> 1-5 bar
- 时间 5-20秒

在预贴合过程中，短时间暴露在60°C胶层温度下不会影响最终的粘接性能。

### 2) 粘接

在预贴合步骤后，从胶带上移除离型纸。定位第二个元器件。施加温度和压力,在粘接时间内达到足够的粘接强度。

设置：

- 温度<sup>1</sup> 75-110°C
- 压力<sup>2</sup> 5-10bar
- 时间 10-480秒

温度、压力和时间将取决于材料的类型和厚度。通常，较厚的材料或较低的粘接温度将需要更长的粘接时间。

在110°C的胶层温度下可以实现较短的循环时间。对于低温激活，增加热压时间或结合短时热压步骤与烘箱固化。

粘接强度值是在标准实验室条件下获得的（材料：PC/PC；粘接条件：温度 = 90 °C；压力 = 10 bar；时间 = 300 秒）。

为了达到最大的粘接强度，表面应保持清洁和干燥。请在粘接后至少等待1-2小时再进行性能测试。最终粘接强度将在24小时后达到。

### 储存

- 德莎建议在阴凉干燥的条件下，使用原包装储存胶带。
- 在粘接前的任何时刻（包括运输、储存和加工过程），tesa® LTC都不应暴露在超过35°C的环境中。储存温度应长期保持在25°C以下。
- 保质期为生产后12个月。请查阅圆柱形卷芯上的标签，了解实际的保质期。
- 更多详情，请参阅德莎运输指南。

<sup>1</sup>“预贴合”和“粘接”温度指的是在胶层中测量的数据。<sup>2</sup>“预贴合”和“粘接”压力是指从夹具表面直接传递到粘接区域的力。



# tesa® LTC 58722

## 产品信息

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58722>